

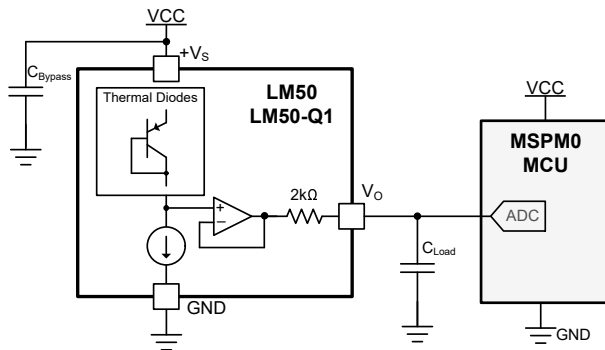
LM50 采用 SOT-23 封装的行业标准 模拟摄氏度 (10mV/°C) 温度传感器

1 特性

- 行业标准级传感器增益/偏移：
 - 10mV/°C，0°C 下 500mV
- LM50B 温度精度：
 - 25°C 时：±2°C (最大值)
 - ±3°C (最大值) (在温度范围内)
- LM50C 温度精度：
 - 25°C 时：±3°C (最大值)
 - ±4°C (最大值) (在温度范围内)
- 工作电源电压范围：4.5V 至 10V
- 静态电流 (典型值)：95 μA
- 提供标准 SOT23-3 封装
- 非线性度：±0.8°C (最大)
- 输出直流阻抗：2kΩ/4kΩ (典型值/最大值)
 - 支持驱动大容量负载
- [UL 认证组件](#)

2 应用

- [手机、PC 和笔记本电脑](#)
- [数据存储](#)
- [电池管理](#)
- [家用和多功能打印机](#)
- [医疗和保健仪器](#)
- [HVAC 系统](#)
- [电源模块](#)



简化版原理图

3 说明

LM50 器件是一款精密模拟温度传感器，可使用单个正电源测量从 -40°C 到 125°C 的温度。该器件的输出电压与温度呈线性比例关系 (10mV/°C)，并在 0°C 时具有 500mV 的直流偏移。此偏移允许在无需负电源的情况下读取负温度值。LM50 的输出电压范围为 100mV (在 -40°C 时) 至 1.75V (在 125°C 时)，从而简化了模数转换器 (ADC) 接口连接。

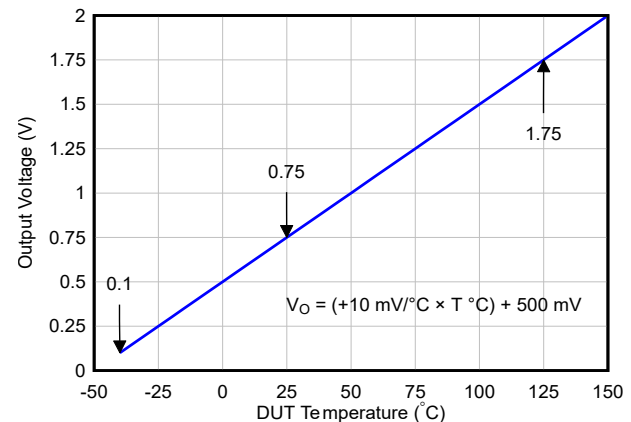
与 NTC 热敏电阻不同，LM50 无需任何外部校准、修整或软件线性化，从而简化了单电源环境中的电路要求。由于 LM50 的静态电流较低 (通常约为 95μA)，自发热限制在非常低的 0.2°C (在静止空气中)，该器件专为远程或电池供电应用而设计。LM50 的晶圆级修整和校准可在以下两个等级提供长期可用性、低成本和一致的精度：LM50B (在 25°C 时为 ±2°C，在整个温度范围内为 ±3°C) 和 LM50C (在 25°C 时为 ±3°C，在整个温度范围内为 ±4°C)。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
LM50	DBZ (SOT-23, 3)	2.37mm × 2.92mm

(1) 有关更多信息，请参阅节 11。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



全量程摄氏温度传感器 (-40°C 至 125°C)



内容

1 特性	1	7.4 器件功能模式	11
2 应用	1	8 应用和实施	12
3 说明	1	8.1 应用信息.....	12
4 器件比较	3	8.2 典型应用.....	12
5 引脚配置和功能	4	8.3 系统示例.....	14
6 规格	5	8.4 电源相关建议.....	15
6.1 绝对最大额定值.....	5	8.5 布局.....	15
6.2 ESD 等级.....	5	9 器件和文档支持	18
6.3 建议运行条件.....	5	9.1 文档支持.....	18
6.4 热性能信息.....	5	9.2 接收文档更新通知.....	18
6.5 电气特性：LM50 (LM50B 和 LM50C)	6	9.3 支持资源.....	18
6.6 典型特性.....	7	9.4 商标.....	18
7 详细说明	11	9.5 静电放电警告.....	18
7.1 概述.....	11	9.6 术语表.....	18
7.2 功能方框图.....	11	10 修订历史记录	18
7.3 特性说明.....	11	11 机械、封装和可订购信息	19

4 器件比较

表 4-1. 器件比较

特性	LM50B ⁽¹⁾	LM50C ⁽¹⁾ LMT90 ⁽¹⁾	TMP235	LM60 ⁽¹⁾	LM61B ⁽¹⁾	LM20B	LM35 ⁽¹⁾
传感器增益 (mV/°C)	10	10	10	6.25	10	-11.77	10
传感器增益类型	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定
失调电压 (0°C) (mV)	500	500	500	424	600	1864	0
温度范围 (°C)	-40 至 125	-40 至 125	-40 至 150	-40 至 125	-25 至 85	-55 至 130	-55 至 150
电源规格							
V _{DD} (V)	4.5 至 10	4.5 至 10	2.3 至 5.5	2.7 至 10	2.7 至 10	2.4 至 5.5	4 至 30
I _Q (典型值) (μA)	95	95	9	82	82	4.5	67
温度精度							
25°C (典型值)	-	-	±0.5	-	-	-	±0.2
-55°C (最大值)	-	-	-	-	-	±2.5	±1
-40°C (最大值)	-3.5/3	±4	±2	±3	-	±2.3	±0.9
-30°C (最大值)	-3.3/2.85	±3.85	±2	±2.85	-	±2.2	±0.85
-25°C (最大值)	-3.2/2.8	±3.8	±2	±2.8	±3	±2.1	±0.8
0°C (最大值)	-2.6/2.4	±3.4	±1	±2.4	±2.5	±1.9	±0.65
25°C (最大值)	±2	±3	±1	±2	±2	±1.5	±0.5
30°C (最大值)	±2.05	±3.05	±1	±2.05	±2.1	±1.5	±0.5
70°C (最大值)	±2.45	±3.45	±1	±2.45	±2.75	±1.9	±0.7
80°C (最大值)	±2.55	±3.55	±2	±2.55	±2.9	±2	±0.7
85°C (最大值)	±2.6	±3.6	±2	±2.6	±3	±2.1	±0.75
100°C (最大值)	±2.75	±3.75	±2	±2.75	-	±2.2	±0.8
125°C (最大值)	±3	±4	±2	±3	-	±2.5	±0.9
130°C (最大值)	-	-	±2	-	-	±2.5	±0.9
150°C (最大值)	-	-	±2	-	-	-	±1
封装尺寸							
尺寸 [mm × mm × mm]	SOT23 (3 引脚) 2.9 × 2.4 × 1.1	SOT23 (3 引脚) 2.9 × 2.4 × 1.1	SOT23 (3 引脚) 2.9 × 2.4 × 1.1 1.1SC70 (5 引脚) 2.0 × 2.1 × 1.1	SOT23 (3 引脚) 2.9 × 2.4 × 1.1 TO92 (3 引脚) 7.4 × 4.8 × 3.7	SOT23 (3 引脚) 2.9 × 2.4 × 1.1 TO92 (3 引脚) 7.4 × 4.8 × 3.7	SC70 (5 引脚) 2.0 × 2.1 × 1.1 DSBGA (4 引脚) 0.96 × 0.96 × 0.6	SOIC (8 引脚) 4.9 × 6.0 × 1.75 TO92 (3 引脚) 7.4 × 4.8 × 3.7 TOCAN (3 引脚) 4.7 × 4.7 × 2.67 TO220 (3 引脚) 15 × 10 × 4.6

1. LM50B、LM50C、LMT90、LM60、LM61B 和 LM35 温度精度限制来自“精度与温度间的关系”图。

表 4-2. LM50/LM50-Q1 器件可订购选项

订货编号	封装	在温度范围内的精度	额定温度范围
LM50BIM3	SOT-23 (DBZ) 3 引脚	±3°C	- 25°C ≤ T _A ≤ +100°C
LM50BIM3X/NOPB ⁽¹⁾			- 25°C ≤ T _A ≤ +100°C (旧芯片)
			- 40°C ≤ T _A ≤ +125°C (新芯片)
LM50CIM3		±4°C	- 40°C ≤ T _A ≤ +125°C
LM50CIM3X			- 40°C ≤ T _A ≤ +125°C (旧芯片和新芯片)
LM50CIM3X/NOPB		±4°C	- 40°C ≤ T _A ≤ +125°C (旧芯片和新芯片)
LM50QIM3X/NOPB			- 40°C ≤ T _A ≤ +125°C (旧芯片和新芯片)

1. LM50BIM3X/NOPB (旧芯片) 的工作温度范围为 - 25°C 至 100°C，而 LM50BIM3X/NOPB (新芯片) 的工作温度范围为 - 40°C 至 125°C。

表 4-3. LM50/LM50-Q1 器件命名规则详细信息

产品	说明
LM50xlyyy	x 表示该器件是具有 B、C 或 Q 变体且符合 AEC-Q100 标准的 1 级器件。这些器件可以随附旧芯片 (CSO : GF6 或 SHE) 或新芯片 (CSO : RFB) 具有不同 芯片源 (CSO)。卷带封装标签提供日期代码信息以区分正在使用的芯片。新芯片和旧芯片的器件性能通篇进行了说明。 yyy 表示器件的封装类型，可为 M3、M3X 和 M3X/NOPB (均采用 SOT-23 3 引脚封装)。

5 引脚配置和功能

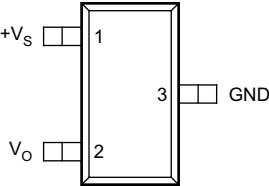


图 5-1. DBZ 封装 3 引脚 SOT-23 顶视图

表 5-1. 引脚功能

引脚		类型	说明
编号	名称		
1	+V _S	电源	正极电源引脚。
2	V _O	输出	温度传感器模拟输出。
3	GND	接地	器件接地，连接到电源负极端子。

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电源电压, $+V_S$	LM50	-0.2	12	V
输出电压, V_O		-1	$+V_S + 0.6$	V
输出电流, I_{OUT}			10	mA
最大结温, T_J			150	°C
贮存温度, T_{stg}		-65	150	°C

(1) 在 **绝对最大额定值** 范围外运行可能会对器件造成永久损坏。**绝对最大额定值** 并不表示器件能够在该等条件下或在任何超出 **建议运行条件** 的其他条件下正常运行。如果在 **建议运行条件** 以外,但在 **绝对最大额定值** 范围以内使用器件可能无法完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能与性能,并且可能缩短器件寿命。

6.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$, 静电放电	LM50	人体放电模型 (HBM), 符合 JESD22-A114 标准 ⁽¹⁾	±2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101	±750	

(1) 人体放电模型是一个通过 1.5k Ω 电阻器对每个引脚放电的 100pF 电容器。机器模型是一个直接对每个引脚放电的 200pF 电容器。

6.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

			最小值	最大值	单位
$+V_S$	电源电压	LM50	4.5	10	V
T_{MIN} 、 T_{MAX}	额定温度	LM50B	-25	100	°C
		旧芯片	-40	125	
		LM50C	-40	125	

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		LM50		单位
		DBZ (SOT-23) 3 引脚		
		旧芯片	新芯片	
R _{θJA}	结至环境热阻	291.9	240.6	°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳（顶部）热阻	114.3	144.5	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	62.3	72.3	°C/W
Ψ _{JT}	结至顶部特征参数	7.4	28.7	°C/W
Ψ _{JB}	结至电路板特征参数	61	71.7	°C/W
R _{θJC(bot)}	结至外壳（底部）热阻	-	-	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息,请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用手册。

6.5 电气特性：LM50 (LM50B 和 LM50C)

LM50：+V_S = 5V (直流) 且 I_{LOAD} = 0.5μA、T_A = T_J = 25°C (除非另有说明) ⁽¹⁾

LM50B (仅限旧芯片)：T_A = T_{MIN} 至 T_{MAX} = -25°C 至 100°C

LM50B (新芯片) 和 LM50C (新芯片和旧芯片)：T_A = T_{MIN} 至 T_{MAX} = -40°C 至 125°C

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
传感器精度							
T _{ACY}	温度精度 ⁽²⁾	T _A = 25°C	LM50B (旧芯片)	-2		2	°C
		T _A = T _{MAX} = 100°C		-3		3	
		T _A = T _{MIN} = -25°C		-3.5		3	
		T _A = 25°C	LM50B (新芯片)	-2		2	°C
		T _A = T _{MAX} = 125°C		-3		3	
		T _A = T _{MIN} = -40°C		-3.5		3	
		T _A = 25°C	LM50C	-3		3	°C
		T _A = T _{MAX} = 125°C		-4		4	
		T _A = T _{MIN} = -40°C		-4		4	
传感器输出							
V _{0°C}	0°C 时的输出失调电压			500			mV
T _C	温度系数 (传感器增益)	T _A = T _J = T _{MIN} 至 T _{MAX}		9.7	10	10.3	mV/°C
V _{ONL}	输出非线性 ⁽³⁾	T _A = T _J = T _{MIN} 至 T _{MAX}		-0.8		0.8	°C
Z _{OUT}	输出阻抗	T _A = T _J = T _{MIN} 至 T _{MAX}		2000		4000	Ω
T _{ON}	开通时间		LM50 (旧芯片)	5			μs
			LM50 (新芯片)	30			
T _{LTD}	长期稳定性和漂移 ⁽⁴⁾	T _J = 125°C, 1000 小时		±0.08			°C
电源							
I _{DD}	工作电流	T _A = T _{MIN} 至 T _{MAX} 4.5V ≤ +V _S ≤ 10V	LM50 (旧芯片)	95		180	μ A
			LM50 (新芯片)	52		90	
PSR	线性调整率 ⁽⁵⁾	T _A = T _{MIN} 至 T _{MAX} 4.5V ≤ +V _S ≤ 10V		-1.2		1.2	mV/V
Δ I _{DD}	静态电流变化量	T _A = T _{MIN} 至 T _{MAX} 4.5V ≤ +V _S ≤ 10V	LM50 (旧芯片)			2	μ A
			LM50 (新芯片)			8	
I _{DD_TEMP}	静态电流的温度系数	T _A = T _{MIN} 至 T _{MAX} 4.5V ≤ +V _S ≤ 10V	LM50B	1			μ A/°C
			LM50C	2			

(1) 限值特定于 TI 的 AOQL (平均出厂质量水平)。

(2) 精度定义为在指定的电压、电流和温度条件下，输出电压与 10mV/°C 乘以器件外壳温度加 500mV 之间的误差 (以 °C 表示)。

(3) 非线性被定义为输出电压和温度的关系曲线在器件的额定温度范围内与最佳拟合直线的偏差。

(4) 为了获得最佳的长期稳定性，任何精密电路在开始长期寿命测试之前，如果器件在较高温度下老化，及/或温度循环至少 46 小时，将能提供最佳效果。当小型 (表面贴装) 器件进行波焊时尤其如此；留出时间让应力放松。大多数漂移将在高温下发生在前 1000 小时内。1000 小时后的漂移不会以第一个 1000 小时的速率持续。

(5) 调整率是在恒定结温下使用低占空比脉冲测试进行测量的。由热效应引起的输出变化可以通过内部耗散乘以热阻来计算。

6.6 典型特性

为了生成这些曲线，将器件安装在印刷电路板上，如 图 8-9 或 图 8-10 所示。

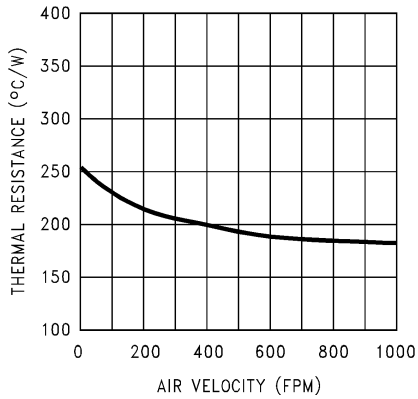


图 6-1. 结至环境热阻 (旧芯片)

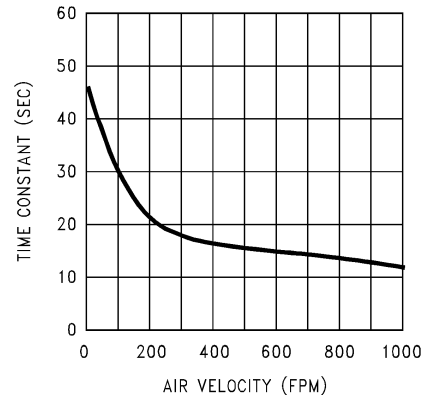


图 6-2. 热时间常数 (旧芯片)

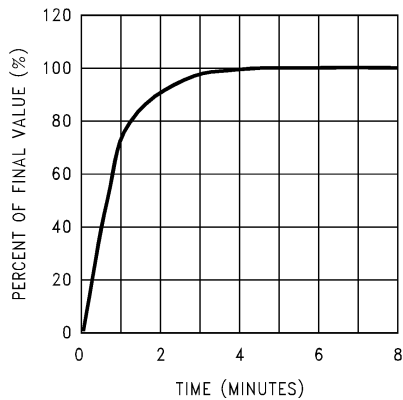


图 6-3. 带散热器时静止空气中的热响应 (旧芯片)

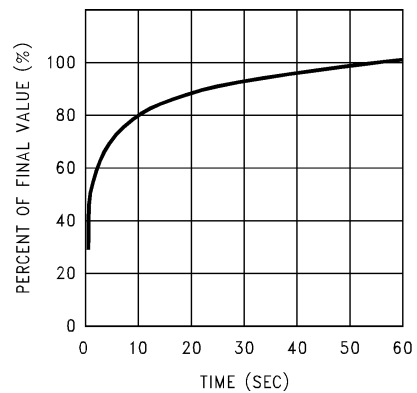


图 6-4. 带散热器时搅拌油浴中的热响应 (旧芯片)

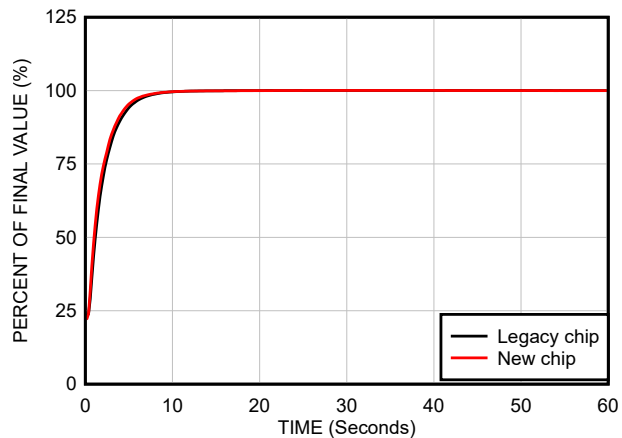


图 6-5. 带散热器时搅拌油浴中的热响应 (0.5 英寸 x 0.5 英寸 PCB 板)

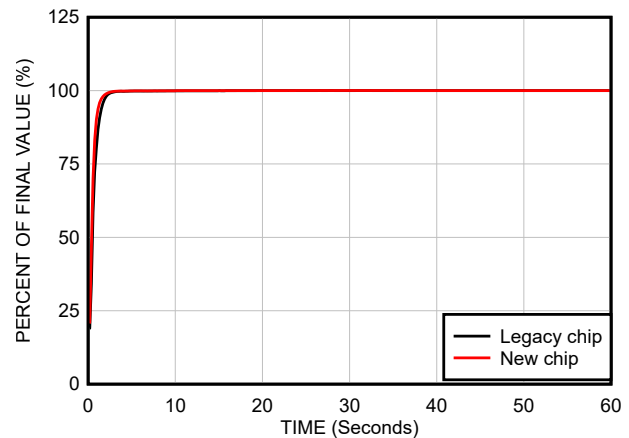


图 6-6. 不带散热器时搅拌油浴中的热响应

6.6 典型特性 (续)

为了生成这些曲线, 将器件安装在印刷电路板上, 如 图 8-9 或 图 8-10 所示。

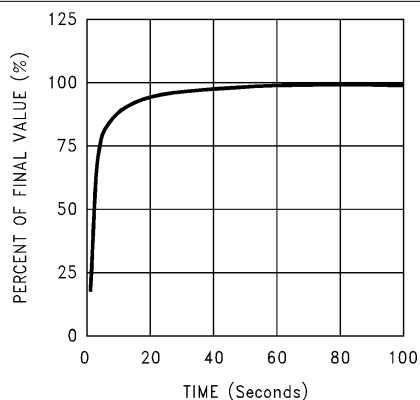


图 6-7. 不带散热器时静止空气中的热响应 (旧芯片)

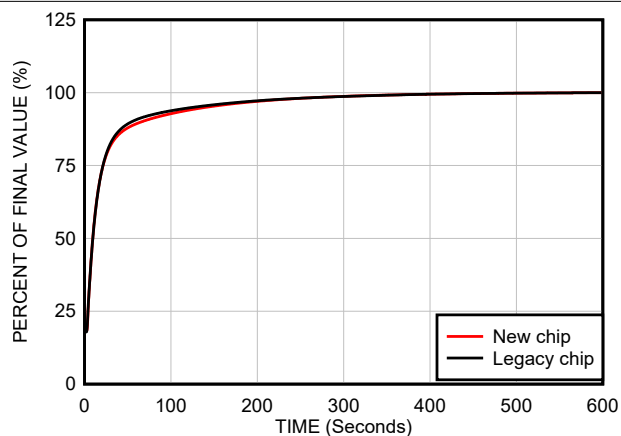


图 6-8. 不带散热器时静止空气中的热响应 (新测试设置中既有旧芯片也有新芯片)

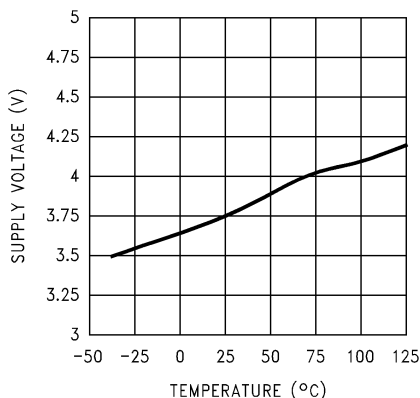


图 6-9. 启动电压与温度之间的关系 (旧芯片)

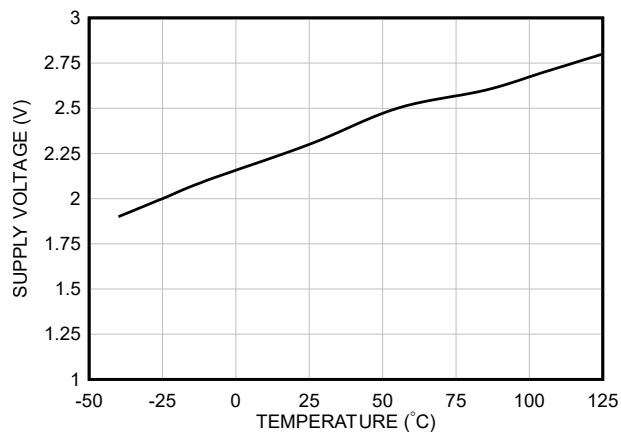


图 6-10. 启动电压与温度之间的关系 (新芯片)

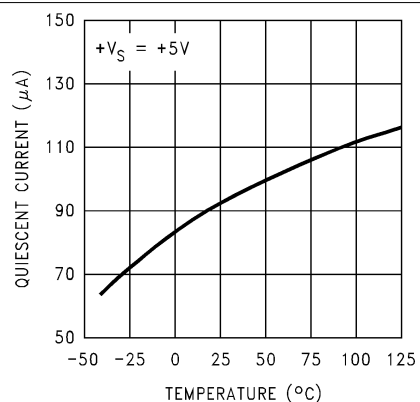


图 6-11. 静态电流与温度之间的关系 (旧芯片)

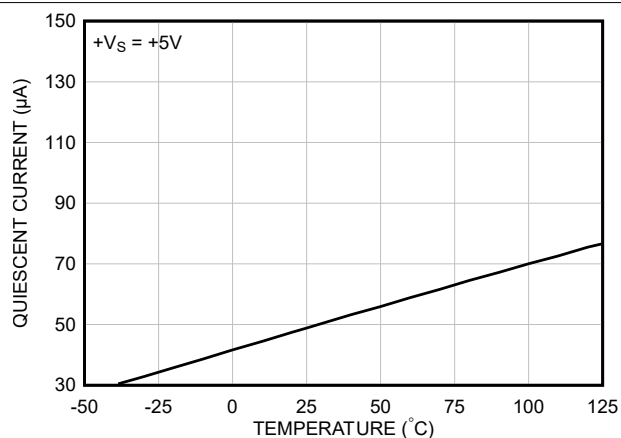


图 6-12. 静态电流与温度之间的关系 (新芯片)

6.6 典型特性 (续)

为了生成这些曲线, 将器件安装在印刷电路板上, 如 图 8-9 或 图 8-10 所示。

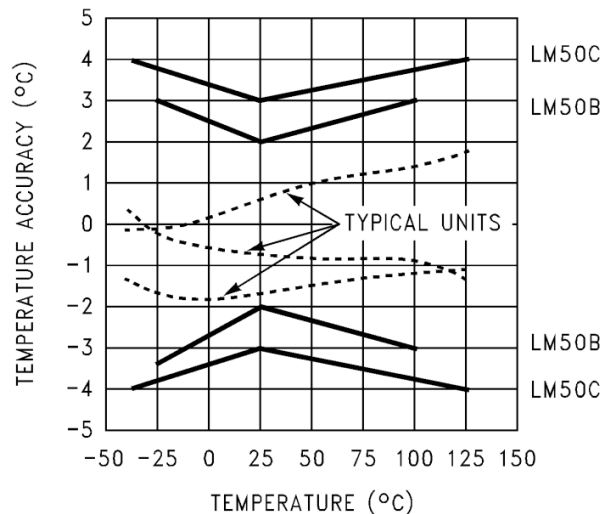


图 6-13. 精度与温度之间的关系 (旧芯片)

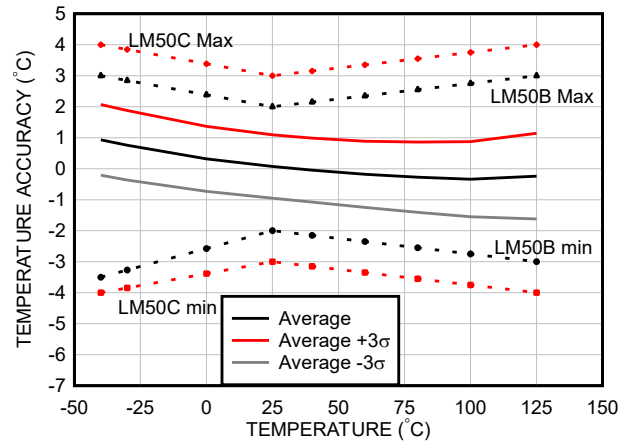


图 6-14. 精度与温度之间的关系 (新芯片)

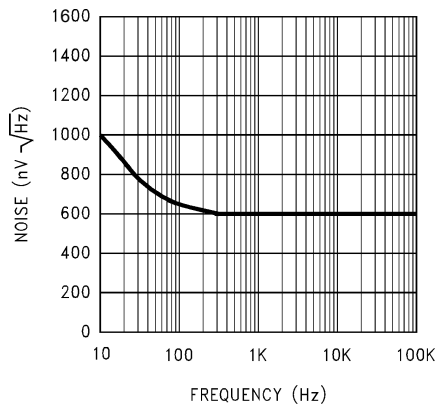


图 6-15. 噪声电压 (旧芯片)

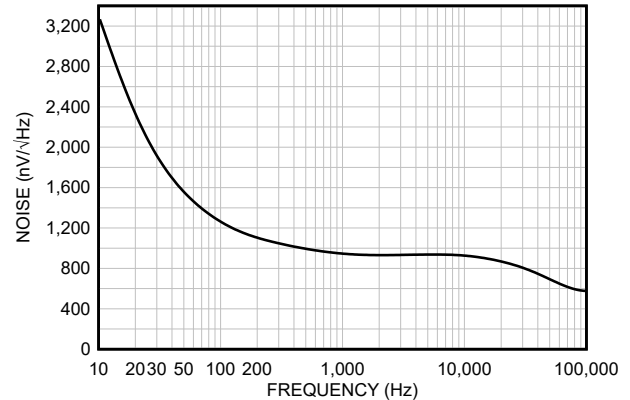


图 6-16. 噪声电压 (新芯片)

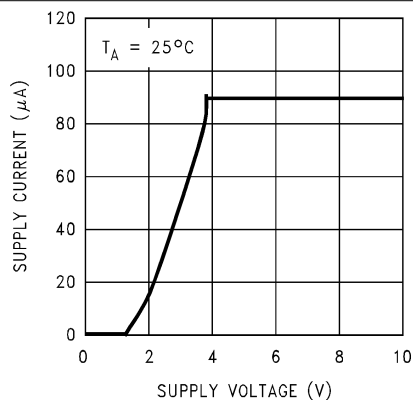


图 6-17. 电源电流与电源电压之间的关系 (旧芯片)

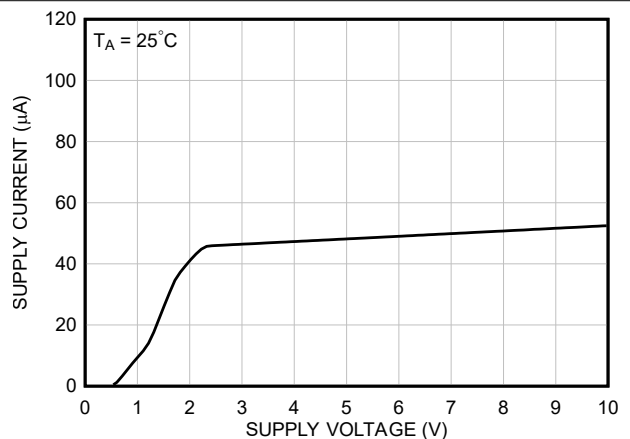


图 6-18. 电源电流与电源电压之间的关系 (新芯片)

6.6 典型特性 (续)

为了生成这些曲线, 将器件安装在印刷电路板上, 如 图 8-9 或 图 8-10 所示。

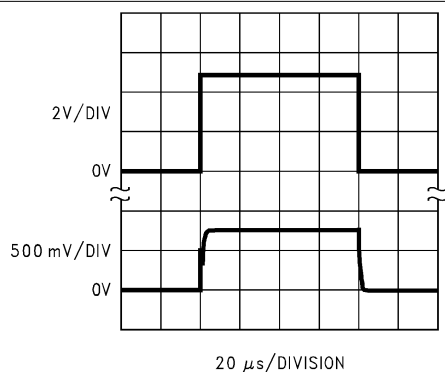


图 6-19. 启动响应 (旧芯片)

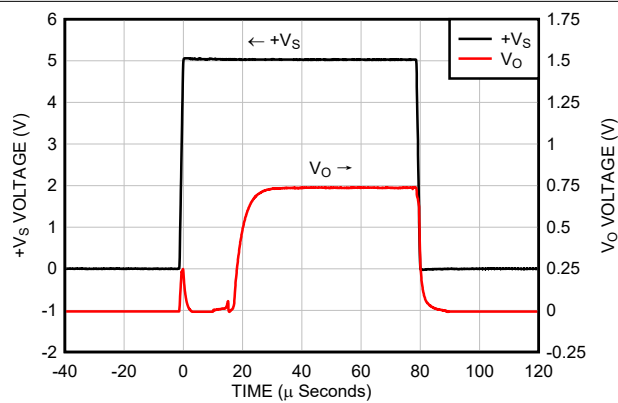


图 6-20. 启动响应 (新芯片)

8 应用和实施

备注

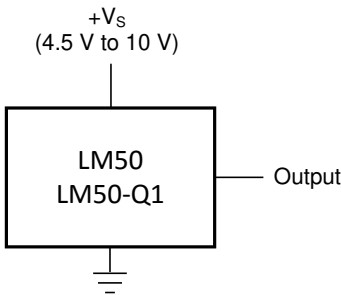
以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

LM50 具有宽电源范围和 10mV/°C 的输出斜率以及 500mV 直流偏移。因此，该器件可轻松应用于许多温度检测应用中，其中正负温度需要单电源。

8.2 典型应用

8.2.1 全量程摄氏温度传感器



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 8-1. 全量程摄氏温度传感器图 (-40°C 至 125°C)

8.2.1.1 设计要求

本设计示例使用表 8-1 中所列的参数作为输入参数。

表 8-1. 设计参数

参数	值
电源电压	4.5V 至 10V
输出阻抗	4k Ω (最大值)
25°C 时的精度	$\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 3^{\circ}\text{C}$ (最大值)
- 40°C 至 125°C 范围内的精度	$\pm 3^{\circ}\text{C}/\pm 4^{\circ}\text{C}$ (最大值)
温度斜率	10mV/°C

8.2.1.2 详细设计过程

LM50 是一款提供模拟输出的简单温度传感器。因此，与布局相关的设计要求比其他要求更重要。有关更多信息，请参阅 [布局](#)。

8.2.1.2.1 容性负载

LM50 能够可靠处理容性负载。如果没有任何特殊预防措施，LM50 可以驱动任何容性负载。该器件具有标称 2k Ω 输出阻抗 (如 [功能方框图](#) 所示)。输出电阻器的温度系数约为 1300ppm/°C。考虑到该温度系数和电阻器的初始容差，器件的输出阻抗不会超过 4k Ω 。在噪声极大的环境中，可能需要添加滤波以更大限度地减少噪声拾取。TI 建议在 +V_S 和 GND 之间添加一个 0.1 μF 电容器以旁路电源电压，如 [图 8-3](#) 所示。可能需要在 V_O 和接地端之间添加一个电容器。具有 4k Ω 输出阻抗的 1 μF 输出电容器形成一个 40Hz 的低通滤波器。由于 LM50 的热时间常数比 RC 形成的 25ms 时间常数慢得多，因此器件的整体响应时间不会受到显著影响。对于更大的电容器，这种额外的时间滞后会增加 LM50 的总体响应时间。

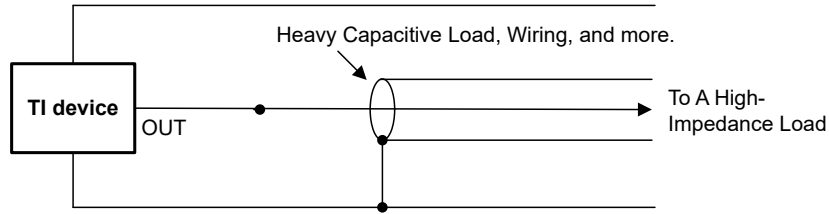


图 8-2. LM50 容性负载无需去耦

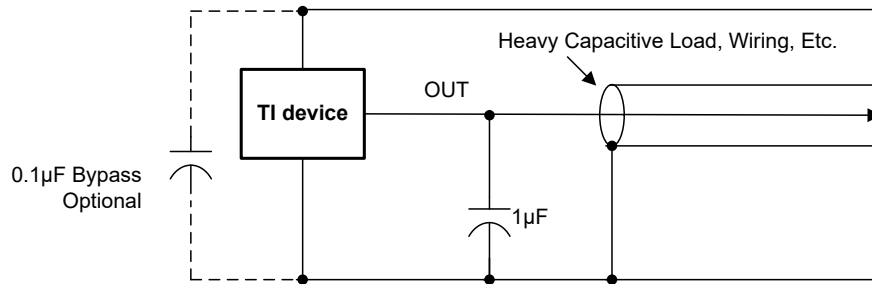


图 8-3. 适用于嘈杂环境带滤波器的 LM50

8.2.1.3 应用曲线

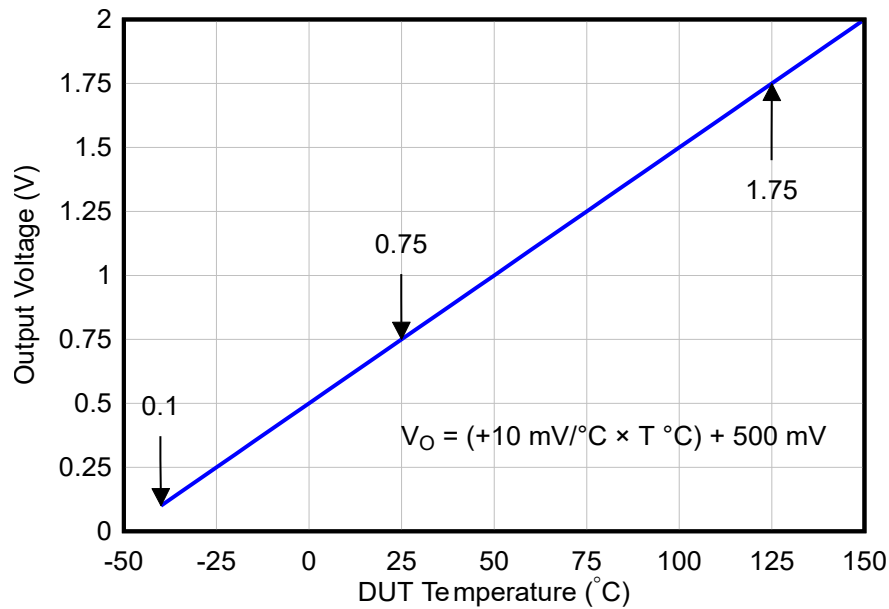
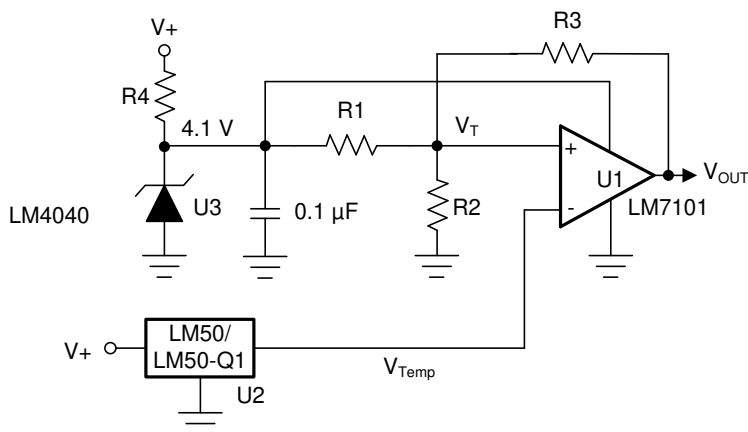


图 8-4. 输出传递函数

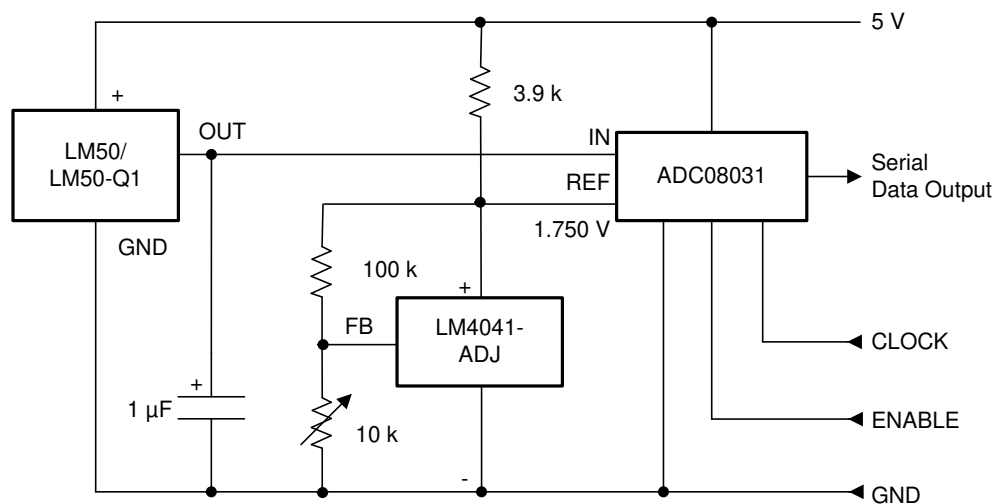
8.3 系统示例

图 8-5 至 图 8-7 显示了使用 LM50 器件的应用电路示例。在根据本节中的示例实施设计之前，客户必须对任何电路进行全面验证和测试。除非另有说明，否则 [全量程摄氏温度传感器](#) 中的设计过程适用。



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

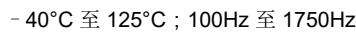
图 8-5. 摄氏温度调节器或风扇控制器



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

125°C 满量程

图 8-6. 温度数字转换器 (串行输出)



8.4 电源相关建议

8.5 布局

8.5.1 布局指南

或者，可将 **LM50** 安装在两端密封的金属管内，然后浸入水槽或拧入水箱的螺纹孔中。与任何器件相同，**LM50** 及随附接线和电路必须保持处于绝缘和干燥状态，以免漏电和腐蚀。如果电路可以在发生冷凝的低温条件下运行，则尤其如此。通常使用印刷电路涂层和清漆（例如 **HUMISEAL®** 和环氧树脂油漆或浸漆）来确保湿气不会腐蚀器件或其连接。

8.5.2 布局示例

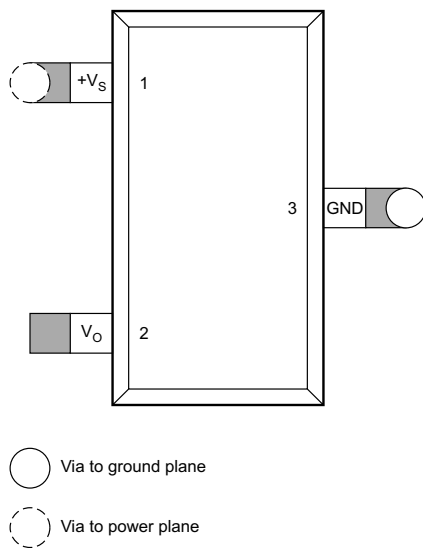
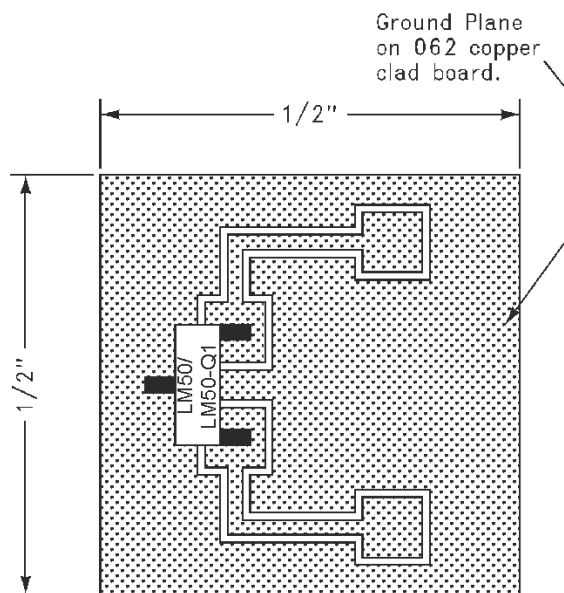


图 8-8. PCB 布局



带有 2 盎司箔片或类似材料的 1/2 英寸方形印刷电路板。

图 8-9. 用于散热器生成热响应曲线的印刷电路板 (旧芯片)

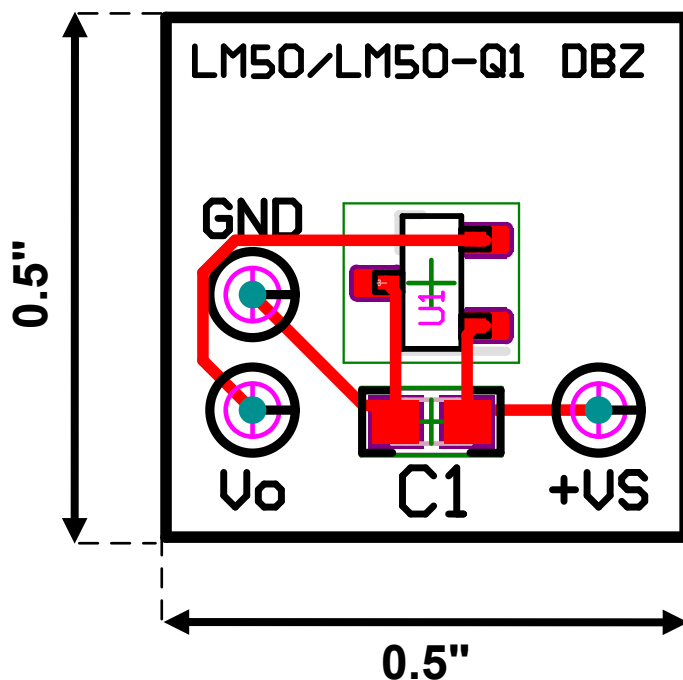


图 8-10. 用于生成热响应曲线的印刷电路板 (新芯片和旧芯片的新测试设置)

8.5.3 散热注意事项

表 8-2 总结了 LM50 在不同条件下的热阻。

表 8-2. LM50 由于自发热而导致的温升

			$R_{\theta JA}$ (°C/W)
SOT-23	无散热器 ⁽¹⁾	静止空气 (旧芯片)	291.9
		流动空气 (旧芯片)	-
	小型散热片 ⁽²⁾	静止空气 (旧芯片)	260
		流动空气 (旧芯片)	180

(1) 器件焊接到 30 号导线。

(2) 使用的散热器是带有 2 盎司箔片的 0.5 英寸方形印刷电路板，其部件安装如 图 8-9 所示。

9 器件和文档支持

9.1 文档支持

相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI), [TMP23x 低功耗高精度模拟输出温度传感器](#), 数据表
- 德州仪器 (TI), [ISOTMP35 具有模拟输出、小于 2 秒响应时间和 500VRMS 工作电压的 \$\pm 1.2^{\circ}\text{C}\$ 、3kVRMS 隔离温度传感器](#), 数据表
- 德州仪器 (TI), [LM60 2.7V、SOT-23 或 TO-92 温度传感器](#), 数据表
- 德州仪器 (TI), [LMT90 SOT-23 单电源摄氏温度传感器](#), 数据表
- 德州仪器 (TI), [远程系统用微型温度传感器](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI), [半导体温度传感器挑战楼宇自动化中的精密 RTD 和热敏电阻](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI), [LMT90 温度传感器评估模块](#), EVM

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知, 请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册, 即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息, 请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料, 可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题, 获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范, 并且不一定反映 TI 的观点; 请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

HUMISEAL® is a registered trademark of Columbia Chase Corporation.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序, 可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级, 大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏, 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision G (January 2017) to Revision H (May 2025)	Page
更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	1
将汽车器件移到了单独的数据表 (SNIS249) 中.....	1
通篇添加了新器件的规格和图表以及旧器件的比较.....	1
添加了 器件比较表 、 可订购器件选项表 和 命名规则详细信息表	3
删除了机器模型 (MM) 静电放电。.....	5
将 LM50B 的额定温度范围从 -25°C 至 100°C (在旧芯片中) 更改为 -40°C 至 125°C (在新芯片中)。.....	5

• 为新芯片添加了 DBZ 封装“热性能信息”	5
• 为旧芯片和新芯片添加了“开通时间”	6
• 为新芯片添加了“工作电流”和“静态电流变化量”	6
• 更新了 设计参数 表以更正错别字	12

Changes from Revision F (December 2016) to Revision G (January 2017)	Page
• 在公式 1 的 V_O 描述中将 LMT90 更改为 LM50	11

Changes from Revision E (September 2013) to Revision F (December 2016)	Page
• 添加了 器件信息 表、 引脚配置和功能 部分、 ESD 等级表、 详细说明 部分、 应用和实施 部分、 电源相关建议 部分、 布局 部分、 器件和文档支持 部分 和 机械、封装和可订购信息 部分	1
• 删除了 温度-数字转换器 (标准数据总线到 μP 接口的并行三态输出) (125°C 满量程) 图	14

Changes from Revision C (February 2013) to Revision E (September 2013)	Page
• 通篇添加了 LM50-Q1 选项	1

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM50BIM3	NRND	Production	SOT-23 (DBZ) 3	1000 LARGE T&R	No	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	T5B
LM50BIM3.B	NRND	Production	SOT-23 (DBZ) 3	1000 LARGE T&R	No	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	T5B
LM50BIM3/NOPB	Obsolete	Production	SOT-23 (DBZ) 3	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	T5B
LM50BIM3X/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T5B
LM50BIM3X/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T5B
LM50BIM3X/NOPB.B	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T5B
LM50CIM3	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	1000 SMALL T&R	No	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T5C
LM50CIM3.B	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	1000 SMALL T&R	No	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T5C
LM50CIM3X	NRND	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	No	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	T5C
LM50CIM3X.B	NRND	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	No	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	T5C
LM50CIM3X/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T5C
LM50CIM3X/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T5C
LM50CIM3X/NOPB.B	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T5C

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

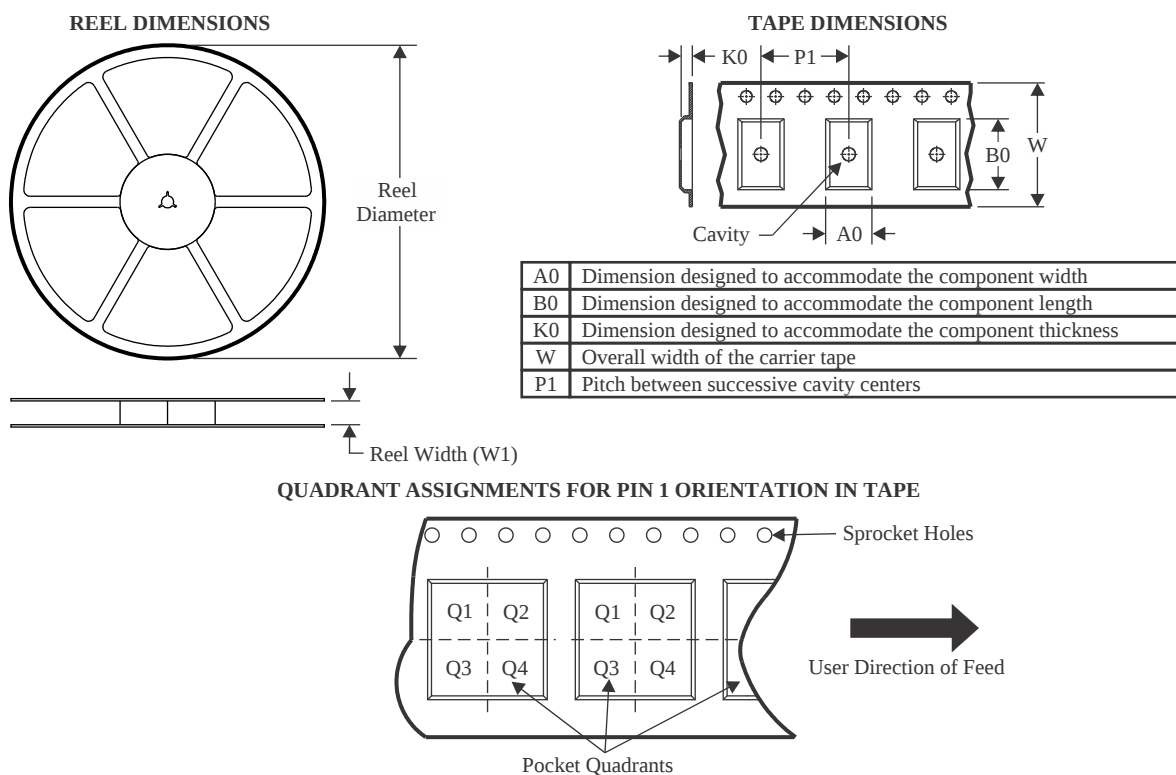
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF LM50 :

- Automotive : [LM50-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

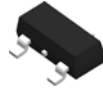
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM50BIM3X/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM50CIM3X/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

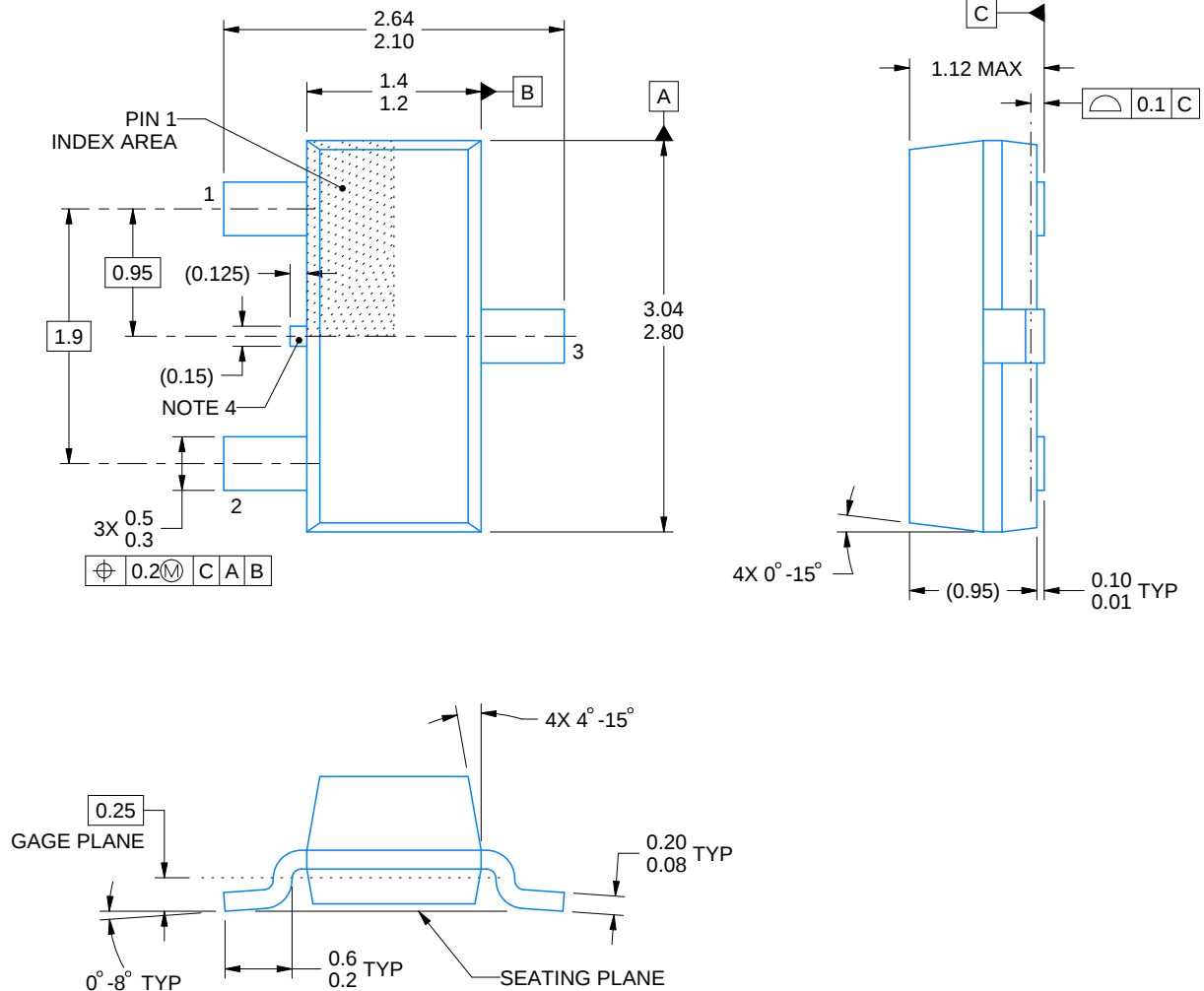


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM50BIM3X/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM50CIM3X/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0

DBZ0003A**PACKAGE OUTLINE****SOT-23 - 1.12 mm max height**

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



4214838/F 08/2024

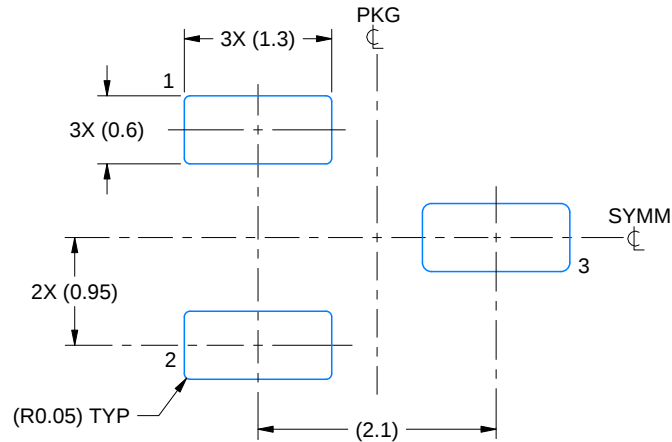
NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration TO-236, except minimum foot length.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side

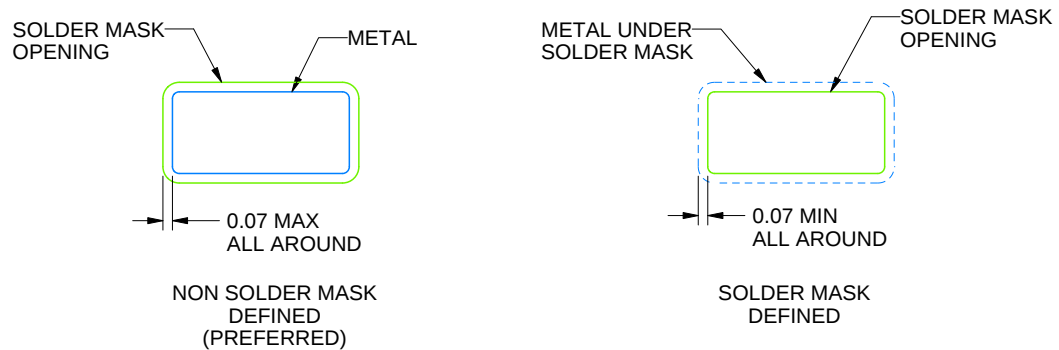
DBZ0003A

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214838/F 08/2024

NOTES: (continued)

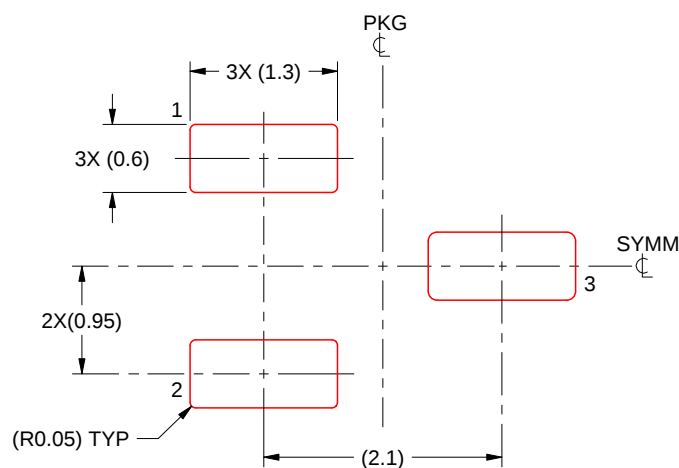
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBZ0003A

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:15X

4214838/F 08/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司